



RE900

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für 14 verschiedene SMD TSOP I und 7 verschiedene SMD TSOP II
- Pitch 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 72,60 x 76,20 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00
RE900-02	TSOP I	0,500 mm	28, 32, 40, 48	12,00 x 20,00
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30